2012 年 11 月 14 日

報道関係者　各位

会社名　　レーザーテック株式会社
東証第二部コード６９２０
横浜市港北区新横浜２－１０－１

代表者名　代表取締役社長　　岡林　理
発表担当　企画 IR 室 室長 浅井　浩志

新製品：　リソグラフィプロセス検査装置

「WASAVI シリーズ LX330」を発表

【概　要】

この度レーザーテック株式会社は、半導体リソグラフィ検査工程での歩留まり向上に極めて有効なリソグラフィプロセス検査装置　WASAVI シリーズ 「**LX330**」を発表致します。

※　WASAVI ： WAfer Surface Analyzing and VIsualizing System

【説　明】

レーザーテックは、半導体リソグラフィ工程でのレジスト塗布・現像後にレジスト膜に出現するCDばらつき、パターン形状ばらつき、異物、及び膜厚不均一性を高速かつ高解像度で検出するマクロ検査装置 WASAVI シリーズ「**LX330**」を製品化いたしました。「**LX330**」は「LP300」の後継機種ですが、新規開発の光学系と信号処理回路等によりEUVLを含む最先端のリソグラフィにも対応可能な高感度化を実現した装置です。

今日、最先端リソグラフィでは、微細化に伴い露光マージンが減少し、レジストパターンの CD 管理やレジスト膜の膜厚管理が一層厳格に要求されております。特に EUVL プロセスでは、十分な実績の無い露光装置や反射型マスクを採用するため、CD の面内ばらつき管理に対する要求が今まで以上に高まっています。

こうした課題に対して、従来使用されている CD-SEM や膜厚計による測定は測定速度が低いため、測定箇所が面内数十ポイントに制限され、ウェハ面内で局所的に発生する CD や膜厚のばらつきを検出する事が困難でした。さらに、EUVL プロセス等のリソグラフィでは、CD の微細化やレジスト膜厚の薄膜化による影響で、マクロ検査の難度も上がっております。

こうした背景から、このたびEUVL等の最先端のリソグラフィにおいても高感度、高速検査が可能な新規光学系を開発しました。本光学系では、現行機種のLP300同様に高解像度マクロ検査機という特長は維持しつつ、光源や撮像系の新規開発による光学レイアウトの一新で、さらなる高感度化を実現したものです。

ウェハ全面の高速、高解像度検査の実現で、量産ラインにおいては、全数検査結果によるプロセス装置のコンディションモニタリングや製品の歩留り向上に向けた的確な対策の推進が可能となります。また、プロセスの開発や立上げ時においては、迅速にプロセス条件の最適化を行うことができます。新製品**「LX330」**をご活用ください。

【用　途】



- 露光装置の Defocus/Dose ばらつきによる
  CD ばらつき・パターン形状検査
- レジスト塗布後の膜厚均一性管理
- レジスト塗布及び現像後におけるミクロンサイズの
  異物・欠陥検査

【特　長】

- 新規検出光学系の採用により EUVL 等の最先端リソグラフィプロセスに適合
- 正確なプロセスモニタリングを実現する自動欠陥分類/判定機能
- 下地の影響を受けず、表面層の情報を取得可能
- 微小なピクセルサイズを選択可能

【仕様】

装置サイズ（mm）	1500(幅) x 2870（奥行） x 2460（高さ）
対応基板サイズ	φ200, 300mm ウェハ

◇お問い合わせ先◇
〒222-8552 横浜市港北区新横浜 2-10-1
レーザーテック株式会社　第一営業部　坪内隆雅
TEL:045-478-7337　FAX:045-478-7333　E-mail: sales@Lasertec.co.jp